

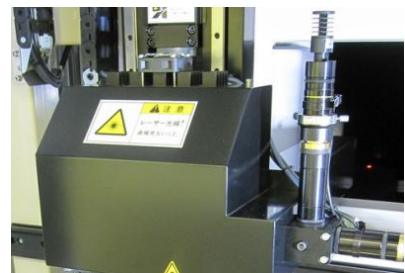
レーザー微細加工機

Laser Micro Processing System LPシリーズ

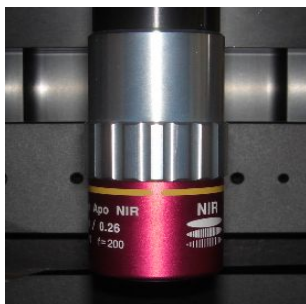
- 高精度・高速加工
- 高付加価値加工
- 加工目的に最適なレーザー発振器に対応
- XYステージ加工、ガルバノスキャン加工、
XYステージ/ガルバノ併用加工
- 加工用途に合わせたカスタマイズ対応
- 加工実験用途から生産装置まで対応



加工機本体



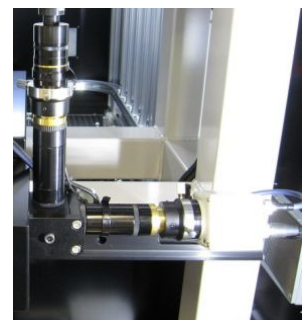
XYステージ加工



対物レンズ加工



ガルバノスキャナ、 $f\theta$ レンズ加工



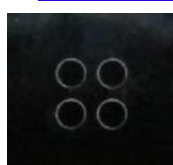
同軸観察系

LPシリーズレーザー微細加工機 装置構成例

レーザー発振器	ピコ秒パルスレーザー(CW~ナノ秒~フェムト秒に対応可)
	波長:1ミクロン帯(10ミクロン~可視~紫外レーザーに対応可)
集光照射光学系	対物レンズ、f θ レンズ、単レンズ交換方式
加工状態、位置確認	同軸光学観測装置内蔵
XYステージ (ボールねじ駆動時)	加工範囲200×200mm(用途により各種サイズ対応可)
	繰返し位置決め精度 \pm 1ミクロン
	分解能0.1ミクロン
Z軸	ストローク100mm
ガルバノスキャナ (f=100mm時)	加工範囲50×50mm
	最大スキャン速度5000mm/s
ワーク周辺	真空ワークチャックホルダー、吸引集塵機 等
入力データ形式	DXFファイルから加工プログラムへの変換 他

* 仕様一例です。この他に各種特別仕様に対応いたします。

LPシリーズ レーザー加工事例



ガラス穴あけ



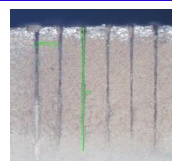
ガラススクライブ



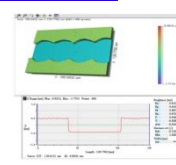
超硬材溝加工



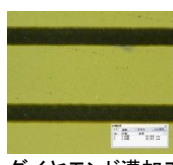
金属高速微細穴あけ



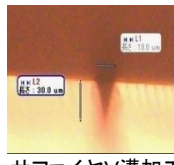
Siスクライブ



薄膜PVスクライブ



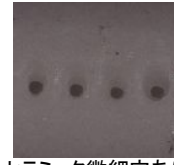
ダイヤモンド溝加工



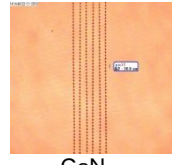
サファイヤV溝加工



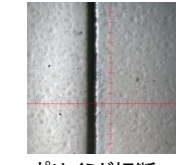
SUS QRコード



セラミック微細穴あけ



GaN



ポリイミド切断

* この他に多数の加工事例がございます。ご相談ください。

株式会社ラステック

〒356-0005 埼玉県ふじみ野市西2-1-25 青木ビル

TEL:049-256-6855 FAX:049-256-6856

E-mail: sales@lastech.co.jp URL: <http://www.lastech.co.jp>